

DIAPOL 790 SL



RESINA POLIÉSTER

✓ Resina sin disolventes

✓ Alta rigidez dieléctrica

CLASE TÉRMICA: H (180°C)

SECADO HORNO

CAMPO DE APLICACIÓN

La resina ha sido estudiada para la impregnación de material estático y dinámico en Clase Térmica H (180°C). Posee gran adherencia al film poliéster, film poliimida, tejido de vidrio y demás aislantes utilizados en la industria eléctrica.

MODO DE EMPLEO

Los tiempos de polimerización varían en función de la pieza a tratar y el sistema de impregnación utilizado. La impregnación se puede efectuar mediante riego o inmersión. En el caso de un precalentamiento de las piezas (40 – 60°C), aconsejamos mantener la temperatura del baño a 30°C como máximo. Un ciclo normal orientativo puede ser de 2 a 4 horas a 150°C.

Este producto es adecuado para su uso con VPI (sistema con vacío y presión), si se requiere.

La resina debe conservarse en su envase original precintado y debe utilizarse antes de que se cumplan 6 meses desde su fecha de fabricación. Si la resina se almacena en una cuba de impregnación, se deberá procurar estabilizar a 30°C de temperatura como máximo, así como mantener una agitación lenta y continuada. El consumo anual deberá ser superior a dos veces la cantidad almacenada.

En caso que se desee reducir la viscosidad, se puede emplear nuestro *Reductor de Viscosidad RV 311*.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIAPOL 790 SL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	DIAPOL 790 SL
Viscosidad a 25°C (Copa Ford 4)	120 ± 20
Densidad a 20°C (g/cm ³)	1.1 ± 0.1
Color	Amarillento
Tiempo en gel a 130°C	7 aprox.
Dureza Shore D	>50
Poder aglomerante 23°C N	160
Poder aglomerante 180°C N	30
Rigidez dieléctrica, 50Hz, 20°C (KV/mm)	130
Rigidez dieléctrica, 50Hz, 180°C (KV/mm)	110
Homologación UL MW35-C (Twisted pair) (°C)	180

FORMA DE SUMINISTRO

En envases metálicos con capacidad de 5 y 25, 200 kg. En contenedores de 1000 Kg.

Rev. Noviembre 2020

Versión: 7

La información que les ofrecemos es de carácter informativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.